

## CSAC NEWS 平成30年2月22日発行 No.100 東京都市大学 産官学交流センター

## 「テクニカルショウ ヨコハマ2018」に材料力学研究室が出展しました

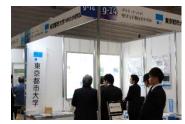
平成30年2月7日(水)~9日(金)の3日間にわたり、パシフィコ横浜にて 開催された「テクニカルショウ ヨコハマ 2018」に工学部機械工学科・材料力学研 究室(岸本 喜直 講師)が出展し、ボルト・ナット締結部の剛性の予測・評価や材 質に応じたボルト・ナットの締付力計算と工程短縮などを可能とするボルト・ナッ トの締付力を予測するシミュレーション技術の紹介を行いました。

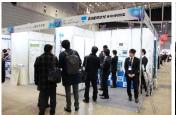
また、会期2日目には「ボルト・ナット締付力の定量評価と簡便化」と題して、 同会場にて岸本講師が出展者セミナーを行いました。



セミナーで発表を行う岸本講師

本イベントは、神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合見本市で、横浜を舞台に過去38回の開催の歴史が あり、地域に根ざした、素材・部品・研究開発・製造及び福祉・環境問題と言ったハードとソフトの総合的な工業見本 市であり、今年度は3日間で36,056名の来場者を記録し、本学出展ブースにも企業関係者など大変多くの方々にご来 場いただきました。









本学出展ブースの様子

研究成果の説明を行う研究室の学生

会場の様子

## 「人工知能・IoT・ビッグデータ分野における産学連携マッチングフェア」出展のお知らせ

人工知能・IoT・ビッグデータ分野において、新しい事業開発や研究開発テーマを模索している企業等と同分野にお いて優れた研究シーズを保有する全国の大学等研究機関の研究者とのマッチングを図ることを目指し、平成30年2月 27 日 (火) に川崎で開催される「人工知能・IoT・ビッグデータ分野における産学連携マッチングフェア」に知識工学 部情報通信工学科・無線システム研究室(岡野 好伸 教授)が出展し、製造・物流・販売の省力化・無人化のための RFID 支援技術の研究成果の展示・発表を行います。

【日 時】平成30年2月27日(火) 展示会およびセミナー 13:00~17:00 / 交流会 17:15~18:30

【場 所】川崎市産業振興会館

【アクセス】JR線「川崎駅」より徒歩8分・京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩7分

【出展者セミナー】平成30年2月27日(火)16時20分~16時50分

【主 催】株式会社キャンパスクリエイト(国立大学法人電気通信大学 TLO)

【共 催】公益財団法人川崎市産業振興財団

■□■ 問い合わせ先 ■□■

東京都市大学 研究推進部 産学官連携センター 〒158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1 TEL:03-5707-0104/FAX:03-5707-2128

E-mail:sangaku@tcu.ac.jp

ホームへ゜ージ:http://www.csac.tcu.ac.jp

